PAT-NO:

JP359062662A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59062662 A

TITLE:

HEAT-RESISTANT RESIN COMPOSITION

PUBN-DATE:

April 10, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OSADA, YUICHI

OKADA, TAISUKE

SHINPO, YASUSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI CHEM CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP57173755

APPL-DATE:

October 1, 1982

INT-CL (IPC): C08L079/08, C08G073/14

US-CL-CURRENT: 528/60

ABSTRACT:

PURPOSE: To prepare the titled composition free from the loss of clarity of the film, having excellent appearance, etc. and suitable as a polyester varnish for enamel wire, etc., by compounding a titanium chelate to a polyester resin having amide-imide bond.

CONSTITUTION: The objective composition is prepared by adding

1∼10pts.wt. of a <u>titanium chelate</u> to a solution containing 100pts.wt. of a <u>polyester</u> resin containing amide-imide bond in the molecular chain and obtained by the thermal reaction of a <u>polyester</u> with an amide-imide oligomer (20∼80wt% based on the resin) consisting of an isocyanate compound, a tribasic acid anhydride and a lactam, in the presence of a chelating agent (e.g. octylene glycol) at normal temperature ∼100°C. The composition is applied directly or together with other insulation coating film to an electrical conductor, and baked to obtain an insulated wire. The composition can be used also as a heat-resistant paint.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-62662

Int. Cl.³
 C 08 L 79/08
 C 08 G 73/14

識別記号

庁内整理番号 6537-4 J 6537-4 J **43公開 昭和59年(1984)4月10日**

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

64耐熱性樹脂組成物

②特

願 昭57-173755

@出

〒昭57(1982)10月1日

仍発 明 者 長田裕一

日立市東町四丁目13番1号日立 化成工業株式会社山崎工場内

@発明者 岡田泰典

日立市東町四丁目13番1号日立

化成工業株式会社山崎工場内

他 明 者 真保靖

日立市東町四丁目13番1号日立 化成工業株式会社山崎工場内

⑪出 願 人 日立化成工業株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番

1号

四代 理 人 弁理士 若林邦彦

明 細 傷

1. 発明の名称

耐熱性樹脂組成物

- 2. 特許請求の範囲
 - 分子鎖中にアミドイミド結合を有するポリ エステル系樹脂とチタニウムキレートとを含 有してなる耐熱性樹脂組成物。
 - 2 分子鎮中にアミドイミド結合を有するボリエステル系樹脂が、イソシアネート化合物、三塩素酸無水物及びラクタムを反応させて得られるアミドイミドオリゴマを用いて得られる伊脂である特許請求の範囲第1項記載の射熱性樹脂組成物。
 - 3. 分子鎖中にアミドイミド結合を有するポリエステル系樹脂が、アミドイミドオリゴマを、分子鎖中にアミドイミド結合を有するポリエステル系樹脂に対して20~80重量多用いて得られる樹脂である特許が水の範囲第1項又は第2項配賊の耐熱性樹脂組成物。
- 3. 発明の詳細な説明

電気機器の小型軽量化や信頼性向上のため, エナメル線について耐熱性、耐摩耗性,熱衝涨 性,加水分解性等の一層の向上が要求されるよ **りになつた。本発明者らは、ポリアミドイミド** 樹脂を用いてポリエステルワニスを改質し、上 述の要求を満足するポリアミドイミドエステル ワニスを得た。普通のポリエステルワニスと何 様に,とのタイプのワニスは、テトラアルキル チタネートを硬化剤として併用することにより。 高速焼付性、カツトスルー等の裏用特性がさら 化向上する。一般にエナメル線用ワニスに硬化 剤としてテトラアルキルチタネートを添加する 場合、添加時のワニス粘度増加を防ぐため通常 は、100~150℃の温度で0.5~3時間程 度の時間をかけて滴下する。通常のポリエステ ル系ワニスでは、このようなテトラアルキルチ タネートの添加によつて樹脂の相分離、皮膜の 失透といつた現象は生じないが、前述したポリ **ナミドイミドエステルワニスに、上述の条件で** テトラアルキルチタネートを忝加すると、場合

持開昭59-62662(2)

により皮膜が失透することを見出した。

本発明者らは、との失透現象を回避するため 税意検討した結果、テトラアルキルチタネート にかえてチタニウムキレートを、アミドイミド エステルワニスに添加することにより、皮膜の 失透現象を防止できることを見出して本発明に いたつた。 へっくみゅい

本発明は、人アミドイミド結合を有するポリエステル系樹脂と、チタニウムキレートを含有する耐燃性樹脂組成物に関する。

本発明に使用する分子鎖中にアミドイミド結合を有するポリエステル系構脂は、(1) すず、アミドイミドオリゴマを合成して、(2) ついでポリエステル構脂と加熱反応させるか、又はアルコール成分、彼成分と加熱反応させることにより得られる。

アミドイミドオリゴマは、イソシアネート化 合物と三塩基酸無水物を、クレゾール、フェノ ール、N-メチルピロリドン等の福性溶媒中で 反応させることにより得られる。価格の点で合

ラクタムとしては、反応性、価格面を考慮すれば、&ーカプロラクタムが好ましい。ラクタムの使用量は、耐熱性を考慮すれば、全イソシアネート当量の100当量多未満が好ましい。ただしラクタムは1モルを2当量として考える。

耐熱性と可とう性の点からイソシアネート化合物と三塩基酸無水物の使用量は、カルポキシル基に対するイソシアネート基の当量比が好ましくは、0.6~1.5、より好ましくは 0.7~1.15の範囲とされる。

反応はすべての原料を问時に仕込んでもよい し、目的に応じて段階的に仕込み反応を進めて もよい。反応温度は、全成分を仕込んだ後の主 反応を195~220℃で行なりのが好ましい。

本発明で使用するアミドイミドオリゴマと加熱反応されるポリエステル樹脂には特に制限はない。このポリエステル樹脂の製造に用いられる酸成分としては、テレフタル酸、イソフタル酸又はその誘導体であるジメチルテレフタレート、ジメチルイソフタレート等の使用が好まし

成格媒としては、フェノール系格別、特にクレ ゾールが好ましい。反応成分としてさらにラク タムを使用すれば、アミドイミドオリゴマの分 子貴が増大してもワニスの獨りが住じにくいた め、ラクタムの使用が好ましい。

イソシアネート化合物としては、トリレンジイソシアネート、44'-ジフェニルメタンジイソシアネートなどの芳香族ジイソシアネートが好ましい。イソシアネート化合物の一部に、イソシアヌレート場合有ポリイソシアネートを使ソシアネート、44'-ジンプインシアネート、イソファネートは、トリレンジイソシアネート、イソファネートは、カリンティートが使用される。

三塩基酸紙水物としては、無水トリメリット 酸、プタントリカルボン酸無水物等があげられる。

い。アルコール成分としては、通常2価以上の アルコールが使用される。 2 価のアルコールと しては、たとえばエチレングリコール、ネオペ ンチルグリコール、1,4-プタンジオール、1, 6ヘキサンジオール、1.6-シクロヘキサンジ メタノール等が用いられ、3価以上のアルコー ルとしては、たとえばグリセリン、トリメチロ ールプロパン、トリスー2 - ヒドロキシエチル イソシアヌレート、ペンタエリスリトール等が 用いられる。耐熱性、耐寒耗性の点から金アル コール成分のうち、30当最多以上は3価以上 のアルコールを使用するのが好ましい。耐クレ ージング性の点からはグリセリンの使用が、耐 熱性、耐冷媒性の点からは、トリスー2ーヒド ロキシエチルイソシアヌレートの使用が特に好 ましい。

酸とアルコールの当最比は、アルコール過剰 率 1 多~ 6 0 多のアルコール過剰が好ましい。 ポリエステル樹脂の合成法には特に制限はない。

本発明においてアミドイミドオリゴマと加熱

持開昭59-62662 (3)

反応されるアルコール成分、酸成分には特に制限はないが、前述のポリエステル樹脂の酸成分、アルコール成分として例示されたものの使用が好ましい。酸とアルコールの当量比はアルコール過剰率1 8~60 8のアルコール過剰が好ましい。

アミドイミドオリゴマの使用最は、分子が中にアミドイミド結合を有するポリエステル系樹脂に対して20~80爪最もの範囲が、耐熱性、ワニスの安定性の点で好ましい。がガアミドイミドオリゴマと、ポセステル樹脂をはついては、アルコール成分とが加熱反応させるについて、アリカーとない。通常はエステルで換ました。 特に制限はない。通常はエステル化触媒たとにはテトラブテルチタネート。酢酸鉛、ジラウレートの微量の存在下に、120~240℃の範囲で行なわれる。もちろん粘度にあわせてクレゾール等の溶媒を追加して合成してもさしつかえない。

ロキシカルポン酸類、アセト酢酸エチル等のケトエステル類、ジアセトンアルコール等のケト アルコール類などがあげられる。

本発明になる耐熱性樹脂組成物はそのままで、 又は必要に応じてエポキン樹脂、フエノールホ ルムアルデヒド樹脂、ポリイソシアネートジエ ネレータ、有機酸金属塩、ポリエーテル樹脂、 ポリエミド樹脂、ポリエステルイミド樹脂、ポ リエステルイミド樹脂、ポ リエステルイミと関語である。 ・ 一種では ・ 一種では ・ 一種で ・ 一世と ・ 一世に

またとのようにして作製された耐熱性樹脂組 成物は耐熱液料としても用いられる。

本発明を比較例及び実施例によつて説明する。 比較例1

本発明に使用されるチタニウムキレートは既 に公知の化合物であり, 各種の方法で合成され るが、たとえばその一つとして、テトラアルキ ルチタネートと配位子となるキレート化剤を加 熱反応させることにより得られる(F. Schmidt, Angew, Chem, 64, 536 (1952), Fh? アルキルチタネートとしては、たとえばテトラ プチルチタネート、テトライソプロピルチタネ ート等があげられる。分子鎖中にアミドイミド 結合を有するポリエステル系側脂を含む溶液に チタニウムキレートを添加されるが、通常常磊 から100℃の福度範囲が好ましく、50~ 80℃の温度がより好ましい。余り高温では配 位子が脱離し、エナメル線皮膜の失透防止効果 が損われるので好ましくない。チタニウムキレ ートは樹脂100重量部に対して1~10瓜最 部の範囲で使用するのが好ましい。キレート化 剤としてはオクチレングリコール、ヘキサンジ オール等のグリコール類、アセチルアセトン等 のβ-ジケトン類、乳酸、サリチル酸等のヒド

成	分	グラム	モル
シメチルテ	レフタレート	5 1 8.0	2.67
エチレング	リコール	1 1 3.0	1.83
グリセリン	•	920	1. 0
テトラプチ (触媒)	・ルチタネート	0.72	
クレゾール	•	3 8.0	

上記成分を温度計、かきまぜ機、分留管をつけた四つロフラスコに入れ窓案気流中で150℃に 昇温し、反応により留出するメタノールを除去しながら反応温度を230℃で6時間かけて昇温し、 同温度で250℃熱板上でのゲル化時間が160 秒以下になるまで反応を進めた。

比較例2

イソシアヌレート **場合有ポリイソシアネートの** 合成

成	分	グラム
トリレンジイ:	ノシアネート	600
キシレン		600
2 - ジメチルア:	ミノエタノール(触媒)	1. 8

上記成分を温度計、かきまぜ機をつけた四つロフラスコ化入れ、温素気流中で140℃に昇温し、同温度でインシアネート基の含有量(初期歳度:48重量を)が25重量をになるまで反応を進めた。

このものの赤外スペクトルには1710cm⁻¹. 1410cm⁻¹ にイソシアヌレート環の吸収が認め られ、2260cm⁻¹ にはイソシアネート基の吸収 が認められた。

比較例3

(1) ポリアミドイミド樹脂の合成

	成	分	グラム	当量
	- ジフコ ソシアオ	Cニルメタン トート	1 1 7.5	0.94
シア		â成したイソ ▶ 環含有ポリ - ト	2 6.7	0.08
e -	カブロラ	194	3 6.7	0.65
無水	トリメリ	リット酸	9 6.0	1.00
クレ	ソール		1 8 0.0	
キシ	レン	•	1 0.0	

参覧 レゾール50人の務務で)249を90分で摘下した。 溶液は半ゲル状となり、評価できるワニスは得ら れなかつた。

比較例5

比較例がで得た不揮発分41重最多の溶液600 多をとり、130℃の温度でナフテン酸亜鉛89、 テトラブチルチタネート(クレゾール50%溶液) 249を90分で滴下した。

実施例1 4

比較例がで得た不揮発分41重量もの溶液600 まをとり、80℃の温度でナフテン酸亜鉛88、 アセチルアセトンをキレート化剤としたチタニウ ムキレート溶液(不揮発分70重量を、松本製薬 LL製TAA)158を90分で流下した。

與施例2

(1) アミドイミドオリゴマの合成

	成	分	グラム	当量
一卜母		成したイソシアヌレ)イソシアネート 存 液)	5 0.0	0.15
4, 4'	7 .	エニルメタンジ	1 1 3.3	0. 9 1

無水トリメリット酸を除く上記成分を温度計、かきまぜ機、分留管をつけた四つロフラスコに入れ、窟案気流中で温度を170℃に昇温し60分間反応を行なう。ついで無水トリメリット酸を添加して温度を210~215℃に上昇して樹脂分25重量をのクレゾール溶液のガードナ砂数が、25℃で160秒になるまで反応を行なつた。得られたポリアミドイミドのメタノール不溶分の7eP/c(DMF,0.5%)は0.26であつた。

比較例4

比較例1で得られた樹脂溶液500分に、比較例3で得られた樹脂溶液400分を添加して、温度を170℃に上昇し、ついでテトラブチルチタネート7分を加え、170℃で6時間保温する。ついで、クレゾール/キシレン=7/3(取像比)の溶液で25℃のガードナ砂数が80秒になるまで希釈する。不揮発分41重量が、30℃での粘度60ポアズの溶液が得られた。

この溶液 6 0 0 g をとり、 8 0 ℃の温度で、オ クテン酸亜鉛 8 g . テトラプチルチタネート (ク

無水トリメリット酸	1 0 9.4	1.14
クレゾール	2 6 0.0	
6 ーカプロラクタム	3 1.1	0.5.5

無水トリメリット酸を除く上記成分を、温度計、かきまぜ機、分留管をつけた四つロフラスコに入れ、160℃で1時間反応を行なつてから、無水トリメリット酸を添加して温度を205~210℃に上昇して、クレゾールの20重冊も溶液の25℃でのガードナ砂数が25秒になるまで反応を進めた。

(2) 分子鎖中にアミドイミド結合を有するポリ エステル系樹脂の合成

	成	分	グラム	当量
ジメタ	・ルテレフ	クタレート	2328	2.4
		: ドロキシ 「ヌレート	2 5 0.6	2.88
テトラ	ブチルタ	・タネート	0. 5	

さらに上記成分を添加して、温度を190℃に 昇温して保温し、250℃グル盤上でのグル化時 間(樹脂0.28)が、200秒になるまで反応を 進めた。ついでクレゾール/キシレン=1/3 (重量比)の榕液で、25℃でのガードナ砂数が 15秒になるまで希釈した。ついでアセチルアセ

トンをキレート化剤としたチタニウムキレート溶 液(不揮発分10重量を、松本製薬工業株式会社 製TAA)を329、ナフテン酸亜鉛209を、 10℃で90分で滴下した。得られたワニスの不

仰発分(200℃ − 2時間)は、38重量%. 30℃での粘度は45ポアメであつた。

比較例3. 実施例1. 実施例2 で得られたワニスを、底径1 mmの網線に焼きつけてエナメル線とした。結果を表1に示した。比較例として標準ポリエステルワニスWH-407(日立化成以,)のエナメル線特性を併記した。エナメル線特性は、JIS C 3003に巻じて綱定した。

を
たりニス焼きつけて得られるエナメル線の外観。
特性ともに良好である。このように分子鎖中にア
ミドイミド結合を有するポリエステル系樹脂とチ
タニウムキレートとの組合せにより得られる耐熱
性樹脂組成物は、エナメル線の良好な外観。特性
をかねそなえており、工業的に有用なものである。

代理人 弁理士 若 林 邦 彦



表1 エナメル線特性

	比被例3	実施例L	実施例2	WH-407
外 観	細粒多 透明性 光沢なし	良	良	良
可とう性 自己径巻付	良	良	良	良
耐熱衛塚性 自己経卷 付合格温度 (℃-1時間)	200	200	200	130
熱軟化性 (荷瓜700分,℃)	310	3 1 2	3 8 5	300

比較例3、比較例4、実施例1、実施例2及び 袋1に示すように分子鎖中にアミドイミド結合を 有するポリエステル系樹脂に、テトラアルキルチ タネートを添加する場合、80℃ではワニスが半 ゲル状になり使用にたえるワニスが得られず、ワ ニスの粘度増加をおさえるために高温で添加する 場合には、エナメル線の外観が、細粒の発生、透 明性、光沢の欠如により低下することがある。こ れに対してチタニウムキレートを使用すれば、低 温で添加してもワニスの粘度上昇がなく、得られ